



Presseinformation

Wafer und Chips jetzt noch einfacher berührungslos messen

Neues Messsystem CHRocodile IT erfasst die Silizium-Dicke mit nur einem Sensor

Eine sehr einfache und gleichzeitig hochgenaue Schichtdickenmessung von Wafern und Chips bietet jetzt das neue CHRocodile IT von Precitec Optronik. Es ist in der Lage, berührungslos mit nur einer Messstelle Silizium zu durchleuchten und exakt Wafer bis zu einer Dicke von 1 mm zu vermessen.

Hintergrund dieses neuen, zerstörungsfreien Messverfahrens ist ein interferometrisch arbeitender Sensor, der nicht, wie üblich, mit Weißlicht sondern mit Infrarotlicht arbeitet.

Vorteil: eine Messstelle mit sehr hellem Licht ermöglicht bei gleichen Bedingungen bis zu 5-mal höhere Messgeschwindigkeiten und einen zehnmahl höheren Messbereich (bis 3,5 mm Luftspalt) gegenüber dem Weißlichtverfahren. Dabei kann die Messeinrichtung durch ihren robusten und einfachen Aufbau direkt in den Waferproduktionsprozess integriert werden. Natürlich bietet sich CHRocodile IT auch als kostengünstige und gleichzeitig hochpräzise Schichtdickenmessung im Labor an.

Das neue System erfasst dabei nicht nur hochgenau die Schichtdicke von Silizium sondern auch von transparenten Folien bis zu einer Stärke von 2,5 mm.

Die erfassten Messwerte stehen dem Anwender für die Prozesskontrolle und -Steuerung, oder auch Exel- Dokumentation zur Verfügung.





Presseinformation

CHRocodile IT bietet damit erhebliche Vorteile für die Wafer- und Folienherstellung:

- Ø Hochgenaue Dickenmessung von nur einer Seite aus
- Ø Berührungsloses und zerstörungsfreies Messverfahren
- Ø 5-mal hellere Lichtquelle, daher 5-mal schnelleres Messen
- Ø 10-mal höherer Messbereich (bis 3,5 mm) als beim Weißlichtverfahren
- Ø Problemlos im Fertigungsprozess zu integrieren
- Ø Klein, kompakt und kostengünstig

Das bedeutet für den Anwender:

- Ø Einhalten hoher Qualitätsstandards bei der Wafer- und Folienherstellung
- Ø Vermeiden von Ausschussproduktion
- Ø Schnelle Amortisation der Ausrüstungsinvestition